

請求の範囲

- [請求項1] 樹脂組成物であって、
エポキシ樹脂、ジアミン化合物、及びポリイミド樹脂を含む樹脂成分と、
前記樹脂組成物の固形分100重量部に対して60重量部以上85重量部以下の、Ba、Ti、Sr、Pb、Zr、La、Ta及びBiからなる群から選択される少なくとも2種を含む複合金属酸化物である誘電体フィラーと、
を含む、樹脂組成物。
- [請求項2] 前記複合金属酸化物が、BaTiO₃、SrTiO₃、Pb(Zr, Ti)O₃、PbLaTiO₃、PbLaZrO₃、及びSrBi₂Ta₂O₉からなる群から選択される少なくとも1種を含む、請求項1に記載の樹脂組成物。
- [請求項3] 前記複合金属酸化物が、BaTiO₃である、請求項1又は2に記載の樹脂組成物。
- [請求項4] 前記樹脂組成物の固形分100重量部に対して、前記誘電体フィラーを70重量部以上85重量部以下含む、請求項1～3のいずれか一項に記載の樹脂組成物。
- [請求項5] 前記ジアミン化合物の含有量が、前記エポキシ樹脂のエポキシ基数を1とした場合に、前記ジアミン化合物の活性水素基数が0.5以上1.5以下となる量である、請求項1～4のいずれか一項に記載の樹脂組成物。
- [請求項6] 前記ジアミン化合物の含有量が、前記エポキシ樹脂のエポキシ基数を1とした場合に、前記ジアミン化合物の活性水素基数が0.8以上1.2以下となる量である、請求項1～5のいずれか一項に記載の樹脂組成物。
- [請求項7] 前記樹脂成分100重量部に対して、前記ポリイミド樹脂を10重量部以上60重量部以下含む、請求項1～6のいずれか一項に記載の

樹脂組成物。

- [請求項8] 前記樹脂成分 100 重量部に対して、前記ポリイミド樹脂を 20 重量部以上 40 重量部以下含む、請求項 1～7 のいずれか一項に記載の樹脂組成物。
- [請求項9] 銅箔と、前記銅箔の少なくとも一方の面に設けられた請求項 1～8 のいずれか一項に記載の樹脂組成物とを含む、樹脂付銅箔。
- [請求項10] 請求項 1～8 のいずれか一項に記載の樹脂組成物が硬化された層である、誘電体層。
- [請求項11] 前記誘電体層の厚さが、 $0.2\ \mu\text{m}$ 以上 $30\ \mu\text{m}$ 以下である、請求項 10 に記載の誘電体層。
- [請求項12] 前記誘電体層の厚さが、 $1\ \mu\text{m}$ 以上 $10\ \mu\text{m}$ 以下である、請求項 10 に記載の誘電体層。
- [請求項13] 第一銅箔と、請求項 10～12 のいずれか一項に記載の誘電体層と、第二銅箔とを順に備えた、銅張積層板。
- [請求項14] 請求項 10～12 のいずれか一項に記載の誘電体層を有する、キャパシタ素子。
- [請求項15] 請求項 10～12 のいずれか一項に記載の誘電体層を有する、キャパシタ内蔵プリント配線板。
- [請求項16] エポキシ樹脂、ジアミン化合物、及びポリイミド樹脂を含む樹脂成分と、樹脂組成物の固形分 100 重量部に対して 60 重量部以上 85 重量部以下の、Ba、Ti、Sr、Pb、Zr、La、Ta 及び Bi からなる群から選択される少なくとも 2 種を含む複合金属酸化物である誘電体フィラーとを含む樹脂組成物を、銅箔に塗工し乾燥させることを含む、樹脂付銅箔の製造方法。